



2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2019年4月26日
上場取引所 東

上場会社名 新光電気工業株式会社
 コード番号 6967 URL <https://www.shinko.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 豊木 則行
 問合せ先責任者 (役職名) コーポレートコミュニケーション室長 (氏名) 清野 貴博 TEL 026-283-1000
 定時株主総会開催予定日 2019年6月25日 配当支払開始予定日 2019年6月26日
 有価証券報告書提出予定日 2019年6月26日
 決算補足説明資料作成の有無: 無
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2019年3月期の連結業績(2018年4月1日～2019年3月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2019年3月期	142,277	△3.3	4,848	△1.0	7,649	33.5	2,526	△31.1
2018年3月期	147,113	5.2	4,899	49.9	5,730	65.2	3,664	21.9

(注) 包括利益 2019年3月期 7,971百万円(75.3%) 2018年3月期 4,548百万円(△8.6%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2019年3月期	18.70	—	1.8	4.2	3.4
2018年3月期	27.13	—	2.7	3.1	3.3

(参考) 持分法投資損益 2019年3月期 ー百万円 2018年3月期 ー百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2019年3月期	180,793	139,200	77.0	1,030.43
2018年3月期	183,759	134,606	73.3	996.42

(参考) 自己資本 2019年3月期 139,200百万円 2018年3月期 134,606百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2019年3月期	18,456	△15,105	△3,441	46,315
2018年3月期	21,806	△19,273	△3,441	45,666

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2018年3月期	—	12.50	—	12.50	25.00	3,377	92.1	2.5
2019年3月期	—	12.50	—	12.50	25.00	3,377	133.7	2.5
2020年3月期(予想)	—	12.50	—	12.50	25.00		63.7	

3. 2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日～2020年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	70,800	△3.3	2,000	△47.0	2,200	△65.4	1,300	△54.0	9.62
通 期	149,200	4.9	7,700	58.8	8,100	5.9	5,300	109.8	39.23

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動): 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料14ページ「4. 連結財務諸表および主な注記(5) 連結財務諸表に関する注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数

2019年3月期	135,171,942株	2018年3月期	135,171,942株
2019年3月期	81,848株	2018年3月期	81,793株
2019年3月期	135,090,144株	2018年3月期	135,090,149株

(参考) 個別業績の概要

1. 2019年3月期の個別業績(2018年4月1日～2019年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2019年3月期	136,003	△2.5	5,096	14.6	8,584	57.0	3,572	2.0
2018年3月期	139,464	5.3	4,448	69.3	5,466	68.3	3,502	10.4

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2019年3月期	26.45	—
2018年3月期	25.93	—

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2019年3月期	177,591	138,317	77.9	1,023.89
2018年3月期	179,066	138,122	77.1	1,022.45

(参考) 自己資本 2019年3月期 138,317百万円 2018年3月期 138,122百万円

※ 決算短信は公認会計士または監査法人の監査の対象外です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

なお、業績予想に関する事項は添付資料3ページ「1. 経営成績等の概況(1) 当期の経営成績の概況 ② 今後の見通し」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	4
(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当	4
2. 経営方針	5
(1) 経営の基本方針	5
(2) 中長期的な経営戦略	5
3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	6
4. 連結財務諸表および主な注記	7
(1) 連結貸借対照表	7
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	9
連結損益計算書	9
連結包括利益計算書	10
(3) 連結株主資本等変動計算書	11
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	13
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	14
(継続企業の前提に関する注記)	14
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)	14
(セグメント情報)	17
(1株当たり情報)	18
(重要な後発事象)	19
参考資料	20

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

① 当期の経営成績

当期の経済環境は、日本におきましては、緩やかな景気回復が継続したものの、期後半にかけて海外経済の減速等を背景に景況感が悪化し、先行き不透明感が強まる状況となりました。海外におきましては、米国では、雇用情勢や個人消費に加え、設備投資も堅調に推移するなど緩やかな景気拡大が継続した一方、中国経済は、インフラ投資の抑制や、米中貿易摩擦の影響による輸出の減少などにより、景気の減速が鮮明となりました。

半導体業界につきましては、期前半は半導体需要の拡大等により、メモリー向け、自動車向けをはじめとして好調に推移しましたが、期後半以降、メモリーの供給過剰や米中貿易摩擦等を背景とした在庫調整の影響等により、減速傾向が鮮明となりました。

このような環境下において、当社グループにおきましては、半導体の微細化、高密度化に対応する次世代フリップチップタイプパッケージをはじめ、今後成長が見込まれる市場向けに重点的に経営資源を投下し、また、期後半にかけ総じて在庫調整の影響を受けるなど厳しい状況にあつて、積極的な販売活動を展開するとともに、競争力強化・収益確保をはかるべく生産性向上およびコストダウン等に注力いたしました。

それらの結果、セラミック静電チャックは半導体製造装置向けに売上が増加し、ヒートスプレッダーはサーバー向けの需要が拡大しました。一方、期後半にかけて、リードフレームやIC組立は在庫調整の影響を受けたことにより減収となり、フリップチップタイプパッケージは、期前半において受注が低調に推移したことなどにより、売上が減少しました。これらにより、当期の連結売上高は1,422億77百万円（対前期比3.3%減）となりました。

収益面につきましては、経常利益は高付加価値製品の売上増加や為替差益の計上などにより76億49百万円（対前期比33.5%増）となりましたが、親会社株主に帰属する当期純利益は、リスク分担型企業年金を導入したことによる退職給付制度の移行に伴う損失ならびに固定資産の減損損失を特別損失に計上したことなどにより25億26百万円（同31.1%減）となりました。

セグメント別の状況は次のとおりであります。

プラスチックパッケージ

プラスチックBGA基板は、スマートフォン等のメモリー向けなどが需要変動の影響を受け、IC組立はハイエンドスマートフォン向けに受注は増加したものの、自動車向けの在庫調整等により減収となりました。また、フリップチップタイプパッケージは、期後半以降、受注が回復傾向を示しましたが、期前半において売上が低水準で推移したことなどにより、減収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は751億83百万円（対前期比3.0%減）となりました。

メタルパッケージ

半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、メモリーの供給過剰等による設備投資抑制の影響を受けましたが、底堅い受注が継続し、また、ヒートスプレッダーはサーバー向けに需要が増加し、それぞれ増収となりました。ガラス端子は、光学機器向けの受注が増加した一方で、光通信向けは低調に推移し、リードフレームは、エッチングリードフレームの売上が増加

したものの、プレスリードフレームが在庫調整の影響を大きく受け、減収となりました。これらの結果、当セグメントの売上高は592億33百万円（対前期比2.1%減）となりました。

② 今後の見通し

今後の経済環境は、米国におきましては、良好な雇用・所得環境が景気を下支えするとみられる一方で、外需の悪化が米国経済の下振れ要因となることが懸念されます。中国では、引き続き米中貿易摩擦による輸出入への影響や低調な個人消費等により景気の減速局面が続き、日本におきましても、海外経済の調整等を背景に輸出や設備投資が低調に推移するなど、景気の伸び悩みが懸念される状況にあります。

半導体業界におきましては、次世代移動通信規格（5G）の実用化等を背景として、今後、一層の活用の進展が見込まれるIoT・AI関連市場向けや、自動運転、EV（電気自動車）等の技術開発が加速する自動車向けなど、半導体需要はさらに拡大することが想定されます。その一方、半導体の高機能化・高速化のニーズは一層高まり、高度化する市場ニーズに対し、迅速かつ柔軟に対応し得る開発・生産体制を構築することを要するなど、世界規模での競争が一段と激化することが予想され、厳しい事業環境が続くものと想定されます。

このような環境下にあつて、当社グループにおきましては、サーバー用をはじめとする高性能半導体向けに、今後、需要拡大が見込まれる次世代フリップチップタイプパッケージについて、生産体制強化・増産のための設備投資を高丘工場（長野県中野市）等において展開するとともに、半導体メモリーの高速化・大容量化に対応する次世代プラスチックBGA基板や、中長期的な需要増加が想定される半導体製造装置向けのセラミック静電チャックの量産体制整備を推進するなど、高い成長が見込まれる市場向けに引き続き重点的に経営資源を投下し、市場の成長・拡大を当社の成長に結びつけるべく注力してまいります。

加えて、これまで培ってまいりました多様な半導体実装技術をもとに、高い競争力を持つ製品の開発および生産体制構築に継続的に取り組み、「品質・コスト・納期」を高次元で確立することにより、事業基盤の一層の強化をはかってまいります。

当社グループは、引き続き成長が見込まれる半導体市場にあつて、常にお客様のニーズを起点とし、お客様にとって価値の高い製品・サービスを提供することにより、「限りなき発展」を果たしてまいり所存であります。

以上の状況をふまえ、次期の業績予想といたしましては、連結売上高1,492億円（対前期比4.9%増）、連結経常利益81億円（同5.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益53億円（同109.8%増）を見込んでおります。なお、業績予想の前提となる為替レートは、1米ドル=108円を想定しております。

(2) 当期の財政状態の概況

① 資産、負債および純資産の状況

当連結会計年度末における財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ総資産が 29 億 65 百万円減少し 1,807 億 93 百万円となりました。負債は 75 億 60 百万円減少し 415 億 92 百万円となりました。純資産は 45 億 94 百万円増加し 1,392 億円となりました。この結果、自己資本比率は 77.0%となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は 184 億 56 百万円（前年度比 33 億 50 百万円減）となりました。また、投資活動の結果使用した資金は 151 億 5 百万円（同 41 億 67 百万円減）となりました。財務活動の結果使用した資金は 34 億 41 百万円（同 0 百万円増）となりました。

これらの活動の結果に為替換算差額を加味した当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 6 億 48 百万円増加し 463 億 15 百万円となりました。

(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

当社は、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを経営の最重要施策の一つと考えており、半導体業界の急速な技術革新に対応した設備投資や研究開発投資を通じた強固な企業基盤の確立と将来の事業展開に備えるため、内部留保の充実も考慮し、財政状態、利益水準および配当性向などを総合的に勘案した利益配当を行うことを基本方針としております。

当期における配当につきましては、上記の方針に基づき、期末配当を12円50銭とし、中間配当の12円50銭とあわせて年間25円とさせていただく予定であります。

また、次期における配当につきましては、1株当たり年間25円とさせていただく予定であります。

2. 経営方針

(1) 経営の基本方針

当社は、グローバルな競争が繰り広げられるエレクトロニクス産業にあつて、新たなテクノロジーの開発とその蓄積を原動力として、事業環境の変化に即応できる強靱な「ものづくり」を実現し、高い競争力を持つ優れた製品を開発・製造・販売することによって、限りなき発展を目指しています。また、このような「技術力」、「発展性」とともに、「国際性」、「温かさ」を企業理念として掲げ、世界各国のお客様と取引を行い、各地に拠点を展開するグローバル企業として国際社会での共存共栄を念頭に置き、常に「人と地球環境への温かさ」を考えた経営姿勢で事業を推進し、社会の健全な発展に寄与することを目指しています。

(2) 中長期的な経営戦略

自動運転、EV（電気自動車）等の技術開発が加速する自動車や急速な拡大が想定される IoT 関連市場、また、人々の健康を支える医療分野など、半導体は、今後も市場を拡大することが見込まれています。さらに、次世代移動通信規格（5G）の実用化等を背景とするビッグデータ、AI などの広がりが、経済や社会の仕組みに変化をもたらし、これまでとは次元の異なるイノベーションを生み出す可能性を秘めており、半導体は、その可能性を実現するキーテクノロジーとして革新を続けていくことが期待されています。

一方で、高機能化・高速化等の技術革新および絶えず変化する市場ニーズに対し、迅速かつ柔軟に対応し得る開発・生産体制を構築することを要するなど、世界規模での競争が、さらに一段と激化することが予想されます。

このような産業にあつて、当社グループは、半導体デバイスの優れた機能を人々の生活のなかへともたらすインターコネクトテクノロジーをベースに、高い競争力を持つ製品の開発に努め、ものづくりの革新に継続的に取り組んでまいります。また、キャッシュ・フローを重視し、常に利益を創出できる強固な経営基盤の確立に努め、かつコーポレート・ガバナンスの充実をはかるとともに、以下の項目に重点をおいた経営戦略を展開してまいります。

① お客様起点による製品・サービスの提供

お客様のニーズを的確に把握し、それを実現する開発力・製造力の充実・革新に努め、製造業の原点である「品質・コスト・納期」を高次元で確立することによって、お客様にとって価値の高い製品・サービスをご提供し、その成功を支え、信頼にお応えするとともに、それらの取り組みを通じて自らの発展・成長を目指してまいります。

② 変化に即応できる企業体質の構築

市場環境の変化が激しく、熾烈な競争が繰り返される半導体産業にあつて、変化に即応できる企業体質の構築こそが企業存続・発展の条件ととらえ、全部門において一層の合理化・生産性の向上に努めるとともに、明確に差別化された製品の開発・量産化を進め、企業体質の強化をはかってまいります。

③ SHINKO Wayの推進

社会における新光電気グループの存在意義、大切にすべき価値観、および社員が実践すべき行動指針、守るべき行動規範を示した「SHINKO Way」の実践を通じ、市場において必要とされる企業であることはもとより、株主の皆様のご期待に応え、お取引先や社員、地域社会など企業を取り巻く方々との調和をはかるとともに、地球環境と企業活動の調和を基本理念として環境経営の推進に努めることにより、社会において必要とされる企業であり続けるべく事業を展開してまいります。

3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性および企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、検討を進めていく方針であります。

4. 連結財務諸表および主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	40,241	47,317
受取手形及び売掛金	40,217	36,817
有価証券	6,410	—
商品及び製品	2,589	4,166
仕掛品	7,718	8,180
原材料及び貯蔵品	2,583	3,314
その他	3,895	4,169
貸倒引当金	△10	△4
流動資産合計	103,644	103,961
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	30,500	31,156
機械装置及び運搬具（純額）	25,326	22,371
工具、器具及び備品（純額）	2,185	1,920
土地	6,555	6,625
建設仮勘定	7,895	8,323
有形固定資産合計	72,464	70,397
無形固定資産	1,237	1,234
投資その他の資産		
投資有価証券	46	45
退職給付に係る資産	500	980
繰延税金資産	5,551	3,811
その他	338	387
貸倒引当金	△25	△25
投資その他の資産合計	6,412	5,199
固定資産合計	80,114	76,831
資産合計	183,759	180,793

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	21,595	19,610
短期借入金	600	600
未払金	4,807	6,100
未払法人税等	1,500	1,377
未払費用	7,513	7,933
その他	930	855
流動負債合計	36,947	36,477
固定負債		
退職給付に係る負債	11,712	3,036
その他	492	2,079
固定負債合計	12,205	5,115
負債合計	49,152	41,592
純資産の部		
株主資本		
資本金	24,223	24,223
資本剰余金	24,129	24,129
利益剰余金	95,850	94,999
自己株式	△92	△92
株主資本合計	144,110	143,259
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	0	0
為替換算調整勘定	△2,107	△1,912
退職給付に係る調整累計額	△7,397	△2,146
その他の包括利益累計額合計	△9,504	△4,058
純資産合計	134,606	139,200
負債純資産合計	183,759	180,793

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売上高	147,113	142,277
売上原価	129,704	125,095
売上総利益	17,409	17,182
販売費及び一般管理費	12,510	12,334
営業利益	4,899	4,848
営業外収益		
受取利息	302	409
為替差益	194	2,074
雑収入	350	344
営業外収益合計	847	2,828
営業外費用		
支払利息	2	1
雑支出	13	24
営業外費用合計	15	26
経常利益	5,730	7,649
特別損失		
固定資産除却損	895	725
減損損失	—	1,138
退職給付制度の移行に伴う損失	—	1,996
特別損失合計	895	3,860
税金等調整前当期純利益	4,834	3,789
法人税、住民税及び事業税	1,395	1,851
法人税等調整額	△225	△588
法人税等合計	1,169	1,263
当期純利益	3,664	2,526
親会社株主に帰属する当期純利益	3,664	2,526

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当期純利益	3,664	2,526
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△0	△0
為替換算調整勘定	△330	195
退職給付に係る調整額	1,213	5,251
その他の包括利益合計	883	5,445
包括利益	4,548	7,971
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	4,548	7,971
非支配株主に係る包括利益	—	—

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	24,223	24,129	95,562	△92	143,822
当期変動額					
剰余金の配当			△3,377		△3,377
親会社株主に帰属する当期純利益			3,664		3,664
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	287	—	287
当期末残高	24,223	24,129	95,850	△92	144,110

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計	
当期首残高	1	△1,776	△8,611	△10,387	133,435
当期変動額					
剰余金の配当					△3,377
親会社株主に帰属する当期純利益					3,664
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△330	1,213	883	883
当期変動額合計	△0	△330	1,213	883	1,170
当期末残高	0	△2,107	△7,397	△9,504	134,606

当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	24,223	24,129	95,850	△92	144,110
当期変動額					
剰余金の配当			△3,377		△3,377
親会社株主に帰属する当期純利益			2,526		2,526
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)					
当期変動額合計	—	—	△851	△0	△851
当期末残高	24,223	24,129	94,999	△92	143,259

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計	
当期首残高	0	△2,107	△7,397	△9,504	134,606
当期変動額					
剰余金の配当					△3,377
親会社株主に帰属する当期純利益					2,526
自己株式の取得					△0
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△0	195	5,251	5,445	5,445
当期変動額合計	△0	195	5,251	5,445	4,594
当期末残高	0	△1,912	△2,146	△4,058	139,200

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	4,834	3,789
減価償却費	17,762	15,339
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△375	△2,292
受取利息及び受取配当金	△305	△412
支払利息	2	1
為替差損益 (△は益)	428	△540
有形固定資産除却損	895	725
減損損失	—	1,138
売上債権の増減額 (△は増加)	△4,442	3,531
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,100	△2,752
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,266	△2,156
未払費用の増減額 (△は減少)	209	399
その他	848	3,238
小計	21,025	20,010
利息及び配当金の受取額	305	411
利息の支払額	△2	△1
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	477	△1,963
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,806	18,456
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△1,268	△1,305
定期預金の払戻による収入	1,360	1,274
有形固定資産の取得による支出	△18,612	△14,314
無形固定資産の取得による支出	△319	△279
投資及び長期貸付金の増減額 (△は増加)	△55	△126
その他	△377	△354
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,273	△15,105
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△3,377	△3,377
その他	△64	△64
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,441	△3,441
現金及び現金同等物に係る換算差額	△673	739
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,581	648
現金及び現金同等物の期首残高	47,248	45,666
現金及び現金同等物の期末残高	45,666	46,315

(5) 連結財務諸表に関する注記事項**(継続企業の前提に関する注記)**

該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 10 社

※主要会社名：

SHINKO ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD.、KOREA SHINKO MICROELECTRONICS CO., LTD.、
SHINKO ELECTRIC AMERICA, INC.

(2) 非連結子会社の名称

非連結子会社 SHINKO MICROELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日

12 月末 2 社

3 月末 8 社

12 月末日決算会社は、12 月末決算により連結しております。

連結決算日の不一致による差異に重要なものがある場合には連結決算上調整を行うこととして
おります。

3. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

その他有価証券

(イ) 時価のあるもの……時価法 (評価差額は全部純資産直入法)

(ロ) 時価のないもの……移動平均法による原価法

② デリバティブ

時価法

③ たな卸資産

総平均法および先入先出法による原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 (リース資産を除く)

主に定率法によっております。ただし、当社および国内連結子会社については、1998 年 4 月 1 日以降に取得した建物 (建物附属設備を除く。) ならびに 2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間 (5 年) に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 役員賞与引当金

当社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

（追加情報）

（退職給付制度の改訂）

当社、国内連結子会社および一部の海外連結子会社は、従業員の退職給付制度として確定給付制度および確定拠出制度を設けております。確定給付制度の国内における主要な制度は当社が加入する富士通企業年金基金が運営する外部積立型の年金制度および退職金制度であります。当社は、2018年6月21日に、富士通企業年金基金の年金制度に加入する現役従業員を対象に、勤続年数を含めた会社への貢献度を反映したポイント制を導入するとともに、リスク分担型企業年金を導入いたしました。当該制度は労使でリスクを分担するしくみであり、事業主はリスクへの対応も含む固定の掛金を拠出することにより一定のリスクを負い、加入者も財政バランスが崩れた場合には給付調整が行われることで一定のリスクを負います。現行の確定給付企業年金は、積立不足が生じた時に事業主に追加の掛金負担が生じますが、リスク分担型企業年金は、あらかじめ将来発生するリスクを測定し労使合意によりその範囲内で掛金（リスク対応掛金）を拠出し平準的な拠出とするものです。

退職給付に係る会計処理において、リスク分担型企業年金のうち、企業が追加掛金の拠出義務を実質的に負っていないものは確定拠出制度に分類されます。当社は、「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第33号 平成28年12月16日）を適用し、当社が導入したリスク分担型企業年金は追加掛金の拠出義務を実質的に負っておらず、確定拠出制度に分類されることから、当該制度への移行時点で、移行した部分に係る退職給付債務と当該制度に移行した資産の額との差額を損益として認識するとともに、移行した部分に係る未認識過去勤務費用および未認識数理計算上の差異を損益として認識し、また、これらと負債計上した基金規約に定められた特別掛金相当額との純額を清算損益として特別損益に計上いたします。

この結果、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、退職給付に係る負債が7,602百万円減少し、退職給付に係る資産が1,362百万円増加し、純資産が3,702百万円増加しております。また、当連結会計年度の連結損益計算書において、移行に伴う清算損1,996百万円を特別損失に計上しております。なお、これによる制度移行後の当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産、負債、収益および費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8) 消費税等の会計処理方法………税抜方式

(セグメント情報)

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、半導体パッケージの開発・製造・販売を主な事業内容としており、製品の種類や特性によって分類された事業区分に基づき、国内および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、当該事業区分を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「プラスチックパッケージ」および「メタルパッケージ」の2つを報告セグメントとしております。

「プラスチックパッケージ」は、プラスチック・ラミネート・パッケージ等の製造・販売およびICの組立・販売を行っております。「メタルパッケージ」は、半導体用リードフレーム、半導体用ガラス端子およびセラミック静電チャック等の製造・販売を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

セグメント間の売上高は、主に第三者間取引価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2 (注) 4	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
	プラスチック パッケージ	メタル パッケージ	計				
売上高							
外部顧客への売上高	77,504	60,492	137,997	9,116	147,113	—	147,113
セグメント間の内部 売上高または振替高	—	776	776	2,927	3,703	△3,703	—
計	77,504	61,268	138,773	12,043	150,816	△3,703	147,113
セグメント利益または損 失 (△)	△1,675	7,098	5,423	723	6,146	△415	5,730
その他の項目							
減価償却費	12,252	4,820	17,072	689	17,762	—	17,762
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	4,585	5,569	10,154	559	10,713	6,418	17,132

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に連結子会社の事業によるものであります。

2. セグメント利益または損失の調整額△415百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

3. セグメント利益または損失は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

4. 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額6,418百万円は、主に全社共通部門における投資額であります。

5. セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載していません。

当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2 (注) 4	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
	プラスチック パッケージ	メタル パッケージ	計				
売上高							
外部顧客への売上高	75,183	59,233	134,416	7,861	142,277	—	142,277
セグメント間の内部 売上高または振替高	—	717	717	2,844	3,561	△3,561	—
計	75,183	59,950	135,134	10,705	145,839	△3,561	142,277
セグメント利益または損 失 (△)	1,454	7,125	8,579	△406	8,173	△523	7,649
その他の項目							
減価償却費	9,250	5,373	14,623	715	15,339	—	15,339
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	5,096	3,389	8,485	1,474	9,959	4,256	14,216

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に連結子会社の事業によるものであります。
2. セグメント利益または損失の調整額△523百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
3. セグメント利益または損失は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
4. 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額4,256百万円は、主に全社共通部門における投資額であります。
5. セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額	996.42円	1,030.43円
1株当たり当期純利益金額	27.13円	18.70円

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益金額 (百万円)	3,664	2,526
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 金額 (百万円)	3,664	2,526
期中平均株式数 (千株)	135,090	135,090

(重要な後発事象)**(重要な設備投資)**

当社は、2018年4月27日付「半導体用フリップチップタイプパッケージの生産体制強化に関するお知らせ」にて、次世代フリップチップタイプパッケージの生産体制強化を目的とする設備投資計画（2018～2019年度投資額計215億円）をお知らせしておりましたが、2019年4月26日開催の取締役会において、一層の生産能力増強をはかることを目的とし、本設備投資の増額を決議いたしました。なお、本件につきましては、2019年4月26日付リリース「半導体用フリップチップタイプパッケージへの設備投資の増額について」をご参照ください。

1. 設備投資の目的

フリップチップタイプパッケージは、半導体の微細化、高密度化に対応する半導体パッケージとして、大容量のデータを高速で処理するサーバー向けをはじめ、需要拡大が想定されております。当社におきましては、これらのニーズをふまえ、次世代フリップチップタイプパッケージの生産体制強化をはかるべく、高丘工場（長野県中野市）等において、順次、設備導入・生産ライン構築を行っております。

今後、IoT、AIの活用の進展や、次世代移動通信規格（5G）の実用化等を背景として、次世代フリップチップタイプパッケージは、高性能半導体向けにさらに需要を拡大することが見込まれます。当社におきましてはこれらをふまえ、生産能力の一層の増強をはかることといたしました。

これらにより、既に着手している設備投資分を含め、投資額は540億円（2018～2021年度計）となる見込みです。

2. 設備投資の内容

- | | |
|-----------|---|
| (1) 設備の内容 | 次世代フリップチップタイプパッケージ製造設備 |
| (2) 投資額 | 2018～2021年度投資額計 540億円
本設備投資に必要な資金は自己資金、借入等をもって充当する方針です。 |
| (3) 設置工場 | 高丘工場（長野県中野市）他 |
| (4) 生産能力 | 本設備投資により、フリップチップタイプパッケージの生産能力は、既に着手している設備投資による寄与分を含め、約40%程度増強することを見込んでおります。 |

3. 設備の稼働時期

2020年度より順次稼働を予定しております。

4. 当該設備が営業・生産活動に及ぼす重要な影響

本設備投資の稼働は、2020年度より順次開始することを予定しているため、2020年3月期連結業績に与える影響につきましては軽微であります。

《参考資料》



2019年4月26日
新光電気工業株式会社

2019年3月期 連結および単独決算概要

連結決算

	2018年3月期 (2017年4月1日から 2018年3月31日まで)	2019年3月期 (2018年4月1日から 2019年3月31日まで)
売上高	147,113 百万円	142,277 百万円
営業利益	4,899	4,848
経常利益	5,730	7,649
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,664	2,526

1株当たり当期純利益	27円13銭	18円70銭
設備投資額*	16,813	13,937
減価償却費*	17,489	15,061
研究開発費	3,440	3,221
為替レート(1米ドル)	109円	109円

* 無形固定資産を除く

単独決算

売上高	139,464 百万円	136,003 百万円
営業利益	4,448	5,096
経常利益	5,466	8,584
当期純利益	3,502	3,572

1株当たり当期純利益	25円93銭	26円45銭
1株当たり配当金	25円	25円

《参考資料》

セグメント別売上高 (連結)

(単位：百万円)

セグメント	2018年3月期 (2017年4月1日から 2018年3月31日まで)		2019年3月期 (2018年4月1日から 2019年3月31日まで)		増減率
		構成比		構成比	
		%		%	%
プラスチックパッケージ	77,504	(52.7)	75,183	(52.9)	△3.0
メタルパッケージ	60,492	(41.1)	59,233	(41.6)	△2.1
その他の	9,116	(6.2)	7,861	(5.5)	△13.8
合計	147,113	(100.0)	142,277	(100.0)	△3.3

部門別売上高 (連結)

(単位：百万円)

部門	2018年3月期 (2017年4月1日から 2018年3月31日まで)		2019年3月期 (2018年4月1日から 2019年3月31日まで)		増減率
		構成比		構成比	
		%		%	%
ICリードフレーム	35,017	(23.8)	32,093	(22.6)	△8.4
ICパッケージ	84,923	(57.7)	83,008	(58.3)	△2.3
気密部品	26,518	(18.0)	26,370	(18.5)	△0.6
その他の	653	(0.5)	805	(0.6)	23.2
合計	147,113	(100.0)	142,277	(100.0)	△3.3